



News Release

Amkor、Mentor の高密度アドバンスドパッケージングツールをサポートする 業界初のパッケージ組立デザインキットの提供開始 *Amkor SmartPackage™* は、正確な設計とヘトログニアスインテグレーションパッケージ ソリューションの検証が早くなります

テンピ、アリゾナ、2018年7月18日-Amkor Technology(Nasdaq: AMKR) は、半導体のパッケージング及びテストサービスのリーディングカンパニーの一つです。本日当社のパートナーである Mentor と共に、Amkor の SmartPackage™ Package Assembly Design Kit (PADK) を発表します。これは業界初、Mentor の高密度アドバンスドパッケージ (HDAP) のデザインプロセスとツールをサポートしているものです。Amkor が受賞した High Density Fan Out (HDFO) プロセスと Mentor のソフトウェアと組み合わせる事で、Internet-Of-Things、自動車、ハイスピードコミュニケーション、コンピューティング、人工知能のアプリケーションに使われるアドバンスドパッケージについて迅速かつ、正確な検証結果を提供する事ができます。

「Amkor は、OSAT 業界で HDFO テクノロジーの手法において先行しています。マルチチップパッケージを使用した複雑な IC 構成の登場により、Mentor ベースの PADK の開発を優先した事でサイクルタイムの大幅な短縮をしました」と Ron Huemoeller (Amkor Technology の Research and Development、Corporate Vice President) は述べました。「Mentor のフローには Calibre が含まれており、これはファブレスのエコシステムにとっては、必要不可欠なツールです。我々のお客様は、彼らのソリューションで、実在性の検証が簡単にクローズさせる事ができます。」

今日のスマートアプリケーションに使われる複雑でコンパクトなデザインのデバイスには、ヘトログニアスインテグレーションと Advanced System in Package のような洗練されたパッケージング技術の必要性が増しています。これらのソリューションは、異なる機能を持つ単数、または複数の IC と 2.5D (並列) および 3D 構造の I/O および回路密度の向上の組み合わせで使われます。Amkor の SmartPackage PDAK と Mentor の HDAP ツールフローの組み合わせで、Amkor と Mentor 双方のお客様は、Amkor の HDFO プロセスを使用して、アセンブリ、LVS (layout vs. schematic)、接続性、幾何学性、部品間隔の品折祖を作成し、それらをレビューする機能を備えています。このグラフィック環境は、堅牢なデータが特徴で、物理設計の実装前と実装後に簡単に使用できるため、承認が早くなり検証サイクルを短縮する事ができます。

*Amkor は、Mentor の OSAT Alliance Program に参加した最初の OSAT であり、初めて PADK を構築してお客様に提供しています。と Mentor の BSD 部門を担当している Vice President 兼 General Manager の AJ Incorvaia は述べました。「完璧に検証された PADK の提供する為に、Mentor の実績ある HDAP ツールフローを用いた Amkor の HDFO で、お客様は従来のチップ設計から 2.5D 及び 3D ソリューションに簡単に移行する事ができます」



News Release

この OSAT Alliance Program は、半導体エコシステムと設計のチェーンの中で、HDAP の使用・実装・成長を促進し、システム及びファブレス半導体企業が最新のパッケージテクノロジーのスムーズな導入を可能にします。

About Amkor Technology, Inc.

Amkor Technology は、半導体のパッケージングとテストの外部委託業者としては、最大規模の企業の一つです。1968 年に設立し、Amkor は IC パッケージングとテストのパイオニアとして、そして 250 を超える世界有数の半導体企業、ファウンドリー、エレクトロニクス OEM の戦略的パートナーです。Amkor の営業拠点には、アジア、ヨーロッパ、米国の主要なエレクトロニクスの製造地域に 1000 万平方メートルの床面積の生産拠点、製品開発センター、営業 & サポートオフィスがあります。詳細は、www.amkor.com をご覧ください。

About Mentor Graphics

シーメンスの一事業である Mentor Graphic Corporation は、電子ハードウェア、ソフトウェアデザインソリューション、製品提供、コンサルティングサービスの分野において世界的なリーディングカンパニーであり、またエレクトロニクスや半導体に対して受賞歴のあるサポートを提供できるシステムカンパニーです。詳細については、www.mentor.com をご覧ください。

#

Keywords

WaferLogic
High Density Fan Out
HDFO
Package Assembly Design Kit
PADK
Design Tools
OSAT
Semiconductor packaging
Advanced IC packaging
Assembly and test
Mentor

Social Media: @amkortechology

Contacts

Investor Relations

Chris Chaney
Vice President, Investor Relations
480-786-7594

Media Relations

Debi Polo
Senior Manager, Marketing Communications
480-786-7653